

Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載。ハイエンドGPU搭載可能な奥行き480mm

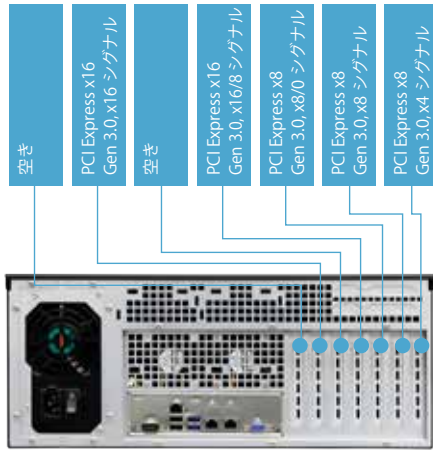
# IPC-S622SPI-R4



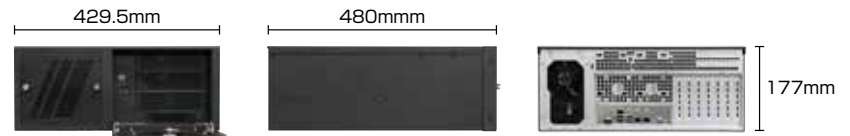
- インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載
- シングルプロセッサーながら、最大20コア (40スレッド)  
※インテル® Xeon® Gold 6138 プロセッサー選択時
- 最大1TBメモリー (DDR4)搭載可能
- ハイエンドGPUボードが搭載可能
- 最大4台の2.5インチSSD/HDDが搭載可能なリムーバブルケージを標準装備
- オプションユニットの追加で、ミドルタワーとしても設置可能



## ■ 拡張スロット構成



## ■ 外観寸法図



## ■ I/O ポート構成



## ■ 製品仕様

プロセッサ	種類	インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ
	搭載数	1
チップセット		インテル® C622 チップセット
メモリー	規格	DDR4 2666MHz ECC
	最大容量	1TB
	スロット数	8
ストレージ	5インチベイ	3 (空き2) ※標準: ストレージ×1で使用。リムーバブルケーシング標準装備で、最大4基の2.5インチSSD/HDDが搭載可能
	3.5インチベイ	内部1
	SATAコネクタ数	6 (空き5) (SATA 3.0) ※標準: ストレージ×1で使用
グラフィックス		Aspeed AST2500 BMC
I/O	VGA	1
	シリアル (COM)	1
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0), 2 (USB2.0)
	LAN	2 (GbE)
	IPMI	1
拡張スロット	SLOT_7	None
	SLOT_6	PCI-Express x16 (x16シグナル、Gen 3.0、CPU側)
	SLOT_5	None
	SLOT_4	PCI-Express x16 (x16/8シグナル、Gen 3.0、CPU側) ※
	SLOT_3	PCI-Express x8 (x8/0シグナル、Gen 3.0、CPU側) ※
	※SLOT_4でx16シグナル時は、SLOT_3は使用不可	
	※SLOT_4でx8シグナル使用時、SLOT_3はx8シグナル使用可能	
SLOT_2	PCI-Express x8 (x8シグナル、Gen 3.0、CPU側)	
SLOT_1	PCI-Express x8 (x4シグナル、Gen 3.0、PCH側)	
外形寸法		4Uラックマウント
		W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く)
重量		約20kg
電源		1200W (80PLUS PLATINUM認証取得)
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10°C~35°C
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10°C~55°C
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部  
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階  
TEL: 03-5446-5535 / hpcs\_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。  
2018年6月12日現在の内容です。